

# 品質要求書

No. B1-56-

作成日：H 年 月 日

※お引き合い内容が複数にわたる場合は、本紙をコピーしてご利用ください。

## 1. ご依頼者

御社名		御住所	〒
御担当者名	様	御所属部署	
TEL		FAX	
E-mail			

## 2. 基板(御支給ワーク)仕様

品名		材質	
寸法	× × <sup>t</sup> (mm)	耐熱温度	
成膜表面への既施工加工	(有⇒		・無)

## 3. 成膜仕様

成膜目的	1.導電性 2.絶縁性【 Ω/□・Ωcm】 3.耐蝕 4.耐摩耗 5.潤滑 6.離型 7.反射 8.透過【 %以上 at nm】 9.その他( )		
成膜面	片面・表裏面・全面・指示部位(図示添付下さい)	添付図面	有・無
	マスキング部位⇒要(図示添付下さい)・不要	基板保持要望部位⇒有( )	・無
薄膜構成	( ) ( Å・μm) / ( ) ( Å・μm) / ( ) ( Å・μm) // 基板		
基板洗浄	要洗浄(指定溶剤があれば⇒ ) ・ 洗浄不要 ・ 洗浄不可		
処理数量	試作： pcs.	量産： pcs./Lot	pcs./月
基板御支給予定日：	ご希望納期：	量産スタートご予定時期：	H 年 月 頃
成膜後検査	1.膜厚(テストピース上での段差測定) 2.密着性(テストピース上でのテープピール) 3.外観(目視) 4.硬度(HV) 5.抵抗値 6.反射・透過率 7.その他( ) 8.元素分析【別途有償】 9.SEM観察【別途有償】(表面・断面) 倍率： ※ 2.密着力に使用するテストピースは、通常、SUSまたはガラスを使用しますが、基板と同素材のテストピースでの検査をご希望の場合は、□20~30程度の小片をご支給ください。		

## 4. ご予算及びお取引方法

ご予算	試作時：¥ 程度	量産時：¥ 程度	or @ 程度
お取引方法	1. 直接取引 2. 商社経由		

## 5. その他特記事項 (ワーク図面がございましたら成膜部位をマーキングの上、添付・同送をお願いします)


### ※工程設計指示 (弊社記入欄)

	承認	担当